

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 14/01/2025 | Edição: 9 | Seção: 1 | Página: 50

Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Gabinete do Ministro

PORTARIA INTERMINISTERIAL MDIC/MCTI Nº 91, DE 8 DE JANEIRO DE 2025

Altera o Processo Produtivo Básico - PPB para MÁQUINA AUTOMÁTICA DIGITAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, COM TELA INCORPORADA - ALL IN ONE, industrializado na Zona Franca de Manaus.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no §6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, no § 1º do art. 2º, art. 4º e nos arts. 11 a 18 do Decreto nº 10.521, de 15 de outubro de 2020, e considerando o que consta no processo nº 19687.002361/2024-22, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, resolvem:

Art. 1º O Processo Produtivo Básico do produto MÁQUINA AUTOMÁTICA DIGITAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, COM TELA INCORPORADA - ALL IN ONE, industrializado na Zona Franca de Manaus, passa a ser composto pelas etapas e respectivas pontuações relacionadas na tabela constante do Anexo I desta Portaria Interministerial.

§ 1º Os pontos totais serão atribuídos a cada etapa de produção realizada, conforme o disposto nos incisos do caput do art. 1º, sendo que a empresa deverá acumular no mínimo a pontuação conforme cronograma disposto no Anexo II, por ano-calendário.

§ 2º O projeto de desenvolvimento a que se refere a etapa I do Anexo I desta Portaria só será pontuado para produto que atenda às especificações, normas e padrões adotados pela legislação brasileira e cujas especificações, projetos e desenvolvimentos tenham sido realizados no País, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e domiciliados no Brasil e atendam às Portarias específicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI.

Art. 2º O investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA) ao exigido pela legislação a que se refere a etapa II do Anexo I desta Portaria deverá ser aplicado, na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá, em programas e projetos de interesse nacional nas áreas de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia - CAPDA.

§ 1º O investimento a que se refere o caput deste artigo deverá ser calculado sobre o faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização com fruição do benefício fiscal, do produto a que se refere esta Portaria, deduzidos os tributos incidentes nesta operação.

§ 2º A comprovação do investimento em PD&IA deverá ser apresentada de forma discriminada junto com o relatório descritivo referente à obrigação estabelecida na Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991.

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste artigo, serão considerados como aplicação em atividades de PD&IA do ano-calendário os dispêndios correspondentes à execução de tais atividades realizadas até 31 de março do ano subsequente.

Art. 3º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada por meio de portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 4º Fica revogada a Portaria Interministerial SEPEC/ME/MCTIC nº 25, de 26 de junho de 2019.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS

Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

ANEXO I

| Etapa | Descrição da etapa produtiva | Pontos Totais |
|-------|---|---------------|
| I | Projeto de Desenvolvimento no País - Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTIC nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, ou Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018, ou Portaria MCTI nº 4.514, de 2 de março de 2021. | 80 |
| II | Investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA), valendo 20 pontos para cada 1% investido, limitado a 60 pontos. | 60 |
| III | Desenvolvimento do software embarcado de baixo nível (firmware) da placa de circuito impresso responsável pelo processamento central. | 20 |
| IV | Corte dos wafers, encapsulamento e teste dos Processadores Principais (CPU). | 130 |
| V | Laminação e corte das placas de vidro e encapsulamento da célula de vidro polarizada. | 120 |
| VI | Injeção, moldagem ou outro processo de conformação (impressão 3D) ou estampagem da carcaça dos gabinetes. | 40 |
| VII | Trefilação e recozimento dos fios dos cabos de força. | 30 |
| VIII | Etchingoujet printing do circuito condutivo, encapsulamento da pastilha, soldagem e inicialização do circuito integrado na antena dos dispositivos de identificação por radiofrequência (RFID). | 20 |
| IX | Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico da placa de circuito impresso que implemente a função de processamento central. | 30 |
| X | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de processamento central. | 140 |
| XI | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de interface de comunicação, quando não integradas à placa principal. | 30 |
| XII | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem a função de fonte de tensão, quando forem internas, e Conversores de Corrente Alternada/Corrente Contínua - CA/CC. | 60 |
| XIII | Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória volátil do tipo RAM. | 150 |
| XIV | Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas que implementem a função de memória volátil do tipo RAM, quando não integradas a outras placas de circuito impresso. | 20 |
| XV | Corte do wafer e encapsulamento e teste dos circuitos integrados de memória do tipo não-volátil do Solid State Drive(SSD) e on board. | 140 |
| XVI | Montagem e soldagem de todos os componentes do Solid State Drive (SSD). | 20 |
| XVII | Montagem e soldagem de todos os componentes na placa principal e montagem das partes e peças do mouse. | 10 |
| XVIII | Montagem e soldagem de todos os componentes na placa principal e montagem das partes e peças do teclado. | 10 |
| XIX | Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final. | 50 |
| XX | Testes. | 10 |
| | TOTAL | 1.170 |

ANEXO II

PONTUAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA POR ANO-CALENDÁRIO

| | | |
|------------------------------|------|----------------|
| ANO-CALENDÁRIO | 2025 | 2026 em diante |
| PONTUAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA | 482 | 514 |

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.